

**快克智能装备股份有限公司**  
**关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署**  
**《进区协议》的补充公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

**重要提示：**

- 投资标的名称：半导体封装设备研发及制造项目（暂定名）。
- 项目实施主体：快克智能装备股份有限公司在项目地新设的全资子公司江苏快克芯装备科技有限公司。
- 预计投资金额：项目预计投资金额约10亿元（预估数，存在不确定性），其中：固定资产投资不少于5亿元（预估数，存在不确定性）。
- 资金来源：公司自有或金融机构借款、资本市场融资等自筹资金。
- 项目投资时间安排：项目建设期约24个月。
- 相关风险提示

1、投资规模风险：本次项目预计投资金额为10亿元，其中固定资产投资不少于5亿元，具体包括土地使用权购置款、基础设施建设款、设备购置款等。该数据为预估数，不具有约束力，后续根据项目投资情况，可能存在项目投资金额不及10亿元的风险。

2、资金风险：截至2022年12月31日，公司经审计货币资金账面余额为5.78亿元，公司2022年度经审计营业收入为90,141.07万元。本项目预计投资金额为10亿元（预估数，存在不确定性），高于目前公司账面货币资金水平，本次项目投资尚存在资金缺口，后续公司将通过自筹、金融机构贷款、资本市场融资等方式补足，如未来融资事项不及预期，可能对项目建设进度产生影响。本次

投资预计投资金额较大，可能带来资金压力。

3、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略和供方生产能力调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

4、土地使用权获得风险：本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

5、政府部门审批风险：投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

6、项目实施风险：本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。综上，本次投资项目存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

7、本项目尚须提交公司股东大会审议。

8、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）于2023年5月8日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进区协议〉的议案》，现将有关情况公告如下：

## 一、对外投资概述

1、基于公司战略规划及经营发展需要，拟在武进国家高新技术产业开发区管理委员会购买土地，并用于投资建设半导体封装设备研发及制造项目，目前正在与武进国家高新技术产业开发区管理委员会协商此事项。

2、本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《公司章程》的相关规定，本次交

易事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司提请董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司主营业务为从事半导体封装设备研发及制造，本项目实施内容属于公司主营业务的范围。

## 二、协议对方的基本情况

1、名称：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

2、性质：地方政府

3、与公司关系：与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系

## 三、项目基本情况

### （一）实施主体

公司名称：江苏快克芯装备科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2023年4月14日

注册资本：叁仟万圆整

法定代表人：戚国强

公司住所：武进国家高新技术产业开发区凤翔路11号

统一社会信用代码：91320412MACFATYC05

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路芯片及产品制造；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设

备修理；人工智能硬件销售；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：公司直接持有100.00%的股权。

## （二）项目的基本情况

项目名称：半导体封装设备研发及制造项目

建设地点：武进国家高新技术产业开发区

投资规模：预计约10亿元，最终以实际投资为准

计划用地：约68亩，以公开出让方式依法取得国有建设用地使用权

资金来源：拟通过自有资金、直接或间接融资等方式

## 四、对外投资合同的主要内容

### （一）协议主体

甲方：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

乙方：快克智能装备股份有限公司

### （二）项目概况

乙方将在武进国家高新区注册成立新公司，投资建设半导体封装设备研发及制造项目；项目总投资10亿元。

### （三）项目用地

甲方向乙方新公司出让国有工业用地约68亩，地块位置位于凤翔路与阳湖西路西北角（具体面积以规划部门宗地图为准）。

### （四）双方责任

甲方积极协助乙方新公司享受政府出台的产业、科技等方面的扶持政策，以促进公司快速发展。

甲方积极做好乙方新公司经营过程涉及的相关服务工作（如立项、环评等手续办理），协调设立过程中出现的矛盾和问题，使公司在武进国家高新区得到健康、快速地发展。

乙方或乙方新公司应在竞得土地后尽快启动建设。

## （五）合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，未尽事宜，经甲乙双方协商后重签补充协议。

## 五、本次交易的目的是对公司的影响

公司投资建设半导体封装设备研发及制造项目，拟进一步加强公司半导体装备业务的研发创新能力及制造产能建设，着力打造半导体封装成套解决方案，积极布局先进封装高端设备领域，提升公司品牌知名度和市场影响力，实现半导体业务板块做大做强。

## 六、风险提示

1、投资规模风险：本次项目预计投资金额为10亿元，其中固定资产投资不少于5亿元，具体包括土地使用权购置款、基础设施建设款、设备购置款等。该数据为预估数，不具有约束力，后续根据项目投资情况，可能存在项目投资金额不及10亿元的风险。

2、资金风险：截至2022年12月31日，公司经审计货币资金账面余额为5.78亿元，公司2022年度经审计营业收入为90,141.07万元。本项目预计投资金额为10亿元（预估数，存在不确定性），高于目前公司账面货币资金水平，本次项目投资尚存在资金缺口，后续公司将通过自筹、金融机构贷款、资本市场融资等方式补足，如未来融资事项不及预期，可能对项目建设进度产生影响。本次投资预计投资金额较大，可能带来资金压力。

3、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略和供方生产能力调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

4、土地使用权获得风险：本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

5、政府部门审批风险：投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工

作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

6、项目实施风险：本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。综上，本次投资项目存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

7、本项目尚须提交公司股东大会审议。

8、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、 备查文件

- 1、快克智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、《进区协议》

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年5月9日